

MAPSIL 213

Résine d'enrobage à faible dégazage

Fiche technique : RE 213
 Création : Janvier 1988
 Révision : n° 11
 Date : 07/05/2008
 Page 1/1



Licence n°89/CNES/6303

Caractéristiques du revêtement

Matrice polymère	➤ Elastomère silicone bicomposant purifié
Densité	➤ 1,00 environ
Extrait sec	➤ 100 %
COV	➤ < 1 g / L
Conductivité thermique	➤ $\lambda \cong 0,15 \text{ W/m.K}$
Dégazage	➤ Conforme à la norme ESA : ECSS-Q-70-02A
Résistance électrique de surface	➤ $R_s > 10^{12} \Omega$
Résistance électrique volumique	➤ $R_v > 10^{14} \Omega/\text{cm}^3$
Températures limites d'emploi	➤ de -100°C à +200°C
Préparation de surface	➤ Nettoyage parfait (nous consulter) Tout collage ultérieur sur la résine étant formellement interdit, prévoir les épargnes nécessaires aux zones de collage.
Proportion massique base / durcisseur	➤ 100 / 10
Pot life	➤ 4 h @ 20°C sans activateur 2 h @ 20°C avec activateur
Conditions d'application	➤ • par coulée (enrobage) : débuller le mélange sous cloche vide (20 mm de Hg) à température ambiante. Couler plusieurs fois, en débullant chaque fois, ou couler sous un vide de 50 mm de Hg. Le moule doit être maintenu à une pression de 20 mm Hg pendant la durée de l'opération. • au pinceau : (couches de 300 µm à 500 µm) Ajouter 1 à 2 doses d'activateur.
Polymérisation	➤ • enrobage : 48 h à 25°C ou 12 h à 65°C • couches minces : – avec activateur : 24 h à 25°C ou 4 h à 25°C puis 4 h en étuve (80°C+/- 20°C) sans activateur : 4 h à 25°C puis 4 h à 100°C

Définition

Résine silicone bicomposante d'enrobage, de collage ou de vernissage, à faible dégazage.

Aspect : **Transparent**

Classement AFNOR NFT 36005 : Famille I Classe 10c.

Destination : Enrobage de modules électroniques pour l'industrie spatiale et les techniques du vide. Adhésifs pour cellules solaires. Vernissage des circuits imprimés. Répond aux normes de sécurité pour vols habités (non-inflammabilité et non-toxicité).

ESA Metallurgy report 2523 (novembre 1998)

Propriétés

Type d'essai	Compte rendu
Dégazage	CNES 89/CT/DRT/TVE/TH n° 074
Propriétés électriques	ESA SP 1173
Chaleur humide	ESA MR 2523
Cyclage thermique	
Propriétés physiques	

Paramètres d'application

MAPSIL 213 se présente sous forme de deux composants à mélanger parfaitement avant l'emploi. MAPSIL 213 s'applique par coulée (enrobage), à la spatule (adhésif) ou au pinceau (vernissage).

Bonne adhérence sur verre. Application préalable du primaire PSX sur composites et alliages métalliques.

Conditionnement

125g (110g Base + 15g Durcisseur)
 250g (220g Base + 30g Durcisseur)
 550g (500g Base + 50g Durcisseur)
 Dose d'activateur = 3 g (pour application en couche fine)

Stockage

6 mois en emballage d'origine plein et fermé entre 5°C et 25°C, à l'abri de l'humidité, sans modification des propriétés.

Données de sécurité

Etiquette ➤ La classification de cette préparation a été exécutée conformément aux directives en vigueur.
 Précautions & Transport ➤ Consulter notre dernière fiche de données de sécurité.

Données techniques indicatives et non contractuelles.

Pour toute information complémentaire, merci de nous consulter.

Les produits et/ ou procédés faisant l'objet du présent document ont été conçus pour accomplir, en oeuvre, une ou plusieurs fonctions déterminées à l'avance, telles qu'elles sont définies ci-dessus. Ces produits et/ ou procédés ne pourront cependant accomplir convenablement lesdites fonctions pendant les durées prévues, que dans la mesure où ils auront été mis en oeuvre conformément aux règles édictées par MAP et en vigueur à l'époque de l'exécution des travaux. Tous cas d'application non explicitement prévus à l'intérieur du présent document, doivent faire l'objet d'une consultation et d'un accord express et formel de MAP, préalablement à l'exécution de tous travaux. La présente édition annule et remplace toutes publications antérieures relatives aux mêmes produits et/ ou procédés. Il appartient aux applicateurs de nos produits de vérifier, auprès de nos Services, que le précédent document n'a pas été annulé par une édition postérieure.